

中钨高新材料股份有限公司 第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司（以下简称中钨高新或公司）第十一届董事会第八次（临时）会议于 2026 年 2 月 10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2026 年向金融机构申请融资额度的议案》

董事会同意公司 2026 年在授信计划 230 亿元内，向金融机构申请总融资额度计划不超过 100 亿元，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票融资、国内信用证、进出口贸易融资等业务。公司可在以上额度内，分配或调剂公司及子公司之间、各金融机构之间授信和融资额度，并循环滚动使用。授权法定代表人签署公司有关融资、授信文件，及出具相应的授权书。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于株硬公司新增 3000 万支 PCB 钻针棒年产能技术改造项目的议案》

为进一步扩大 PCB 钻针棒市场占有率、保障公司 PCB 刀具原料需求、巩固公司 PCB 刀具全产业链龙头地位，董事会同意株洲硬质合金集团有限公司（以下简称株硬公司）以 1.45 亿元实施新增 PCB 钻针棒 3,000 万支/年项目，建设期 12 个月。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

（三）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

为满足株硬公司新增 3,000 万支 PCB 钻针棒年产能技术改造项目建设资金需求，董事会同意公司向株硬公司增资 10,000 万元，增资后株硬公司注册资本将由 245,361.13 万元变为 255,361.13 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

（四）审议通过了《关于新建西南研发中心的议案》

为深入贯彻落实国家创新驱动发展战略，解决公司在西南地区产业集群存在的研发平台分散、高端人才引力不足、创新能力待提升等关键问题，董事会同意公司在成都建设西南研发中心，项目总投资预计为 9,929.80 万元，建设期 18 个月。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

（五）审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》

为满足中钨高新西南研发中心建设项目资金需求，董事会同意公

司与自贡市国有资本投资运营集团有限公司按原股比共同向自贡硬质合金有限责任公司（以下简称自硬公司）增资 9,000 万元，增资完成后自硬公司注册资本将由 87,276.53 万元变为 96,276.53 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 战略与可持续发展委员会决议。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日